

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

24. 3. 2004

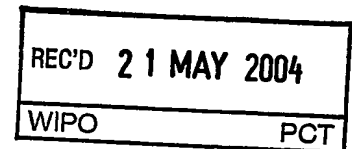
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2003年 3月25日

出 願 番 号
Application Number: 特願2003-083489
[ST. 10/C]: [JP2003-083489]

出 願 人
Applicant(s): 松下電器産業株式会社

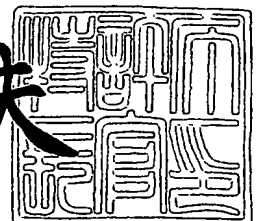


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 4月28日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 2902440012

【提出日】 平成15年 3月25日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 A61B 8/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 武田 潤一

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 小澤 仁

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 110000040

【氏名又は名称】 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ

【代表者】 池内 寛幸

【電話番号】 06-6135-6051

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 139757

【納付金額】 21,000円


【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0108331



【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 超音波探触子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 超音波信号を送受信する振動子と、前記振動子へ、または前記振動子から電気信号を伝送する信号ラインと、前記振動子にグランド電位を供給するグランドラインとを備えた超音波探触子であって、

前記振動子には、センサ信号基板およびセンサグランド基板が電氣的に接続されており、前記センサ信号基板および前記センサグランド基板は、ケーブル基板を介して、それぞれ、前記信号ラインおよび前記グランドラインと電氣的に接続されており、

前記センサグランド基板と前記ケーブル基板とが、直接接続されているか、または、中継グランド基板を介して接続されていることを特徴とする超音波探触子。

【請求項 2】 前記センサ信号基板の少なくとも一部が、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板によって、覆われている請求項 1 に記載の超音波探触子。

【請求項 3】 前記ケーブル基板の少なくとも一部が、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板によって、覆われている請求項 1 または 2 に記載の超音波探触子。

【請求項 4】 前記センサ信号基板と前記ケーブル基板との接続部が、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板によって、覆われている請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の超音波探触子。

【請求項 5】 前記振動子が、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板によって、覆われている請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の超音波探触子。

【請求項 6】 前記センサグランド基板が、前記振動子の超音波送受信面を被覆しており、音響整合板として機能する請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の超音波探触子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、超音波を被検者の体内に放射し、各体内組織の境界で反射する超音波から体内の断層像を作成し表示する超音波診断装置に用いられる超音波探触子に関するものである。

【0002】**【従来の技術】**

超音波診断装置は、生体に対して超音波の送受信を行なうことにより、生体内の2次元情報を得るものであり、各種医療分野で活用されている。この超音波診断装置は、超音波を被検者の体内に送波し、その体内組織からの反射波を受波するための探触子を備えている。

【0003】

図5は、従来の超音波診断装置を構成する探触子の一例を示す模式的な断面図である。この超音波探触子は、センサ部200と、ケーブル部201と、超音波診断装置本体（図示せず。）に接続されるコネクタ部202とを備えている。

【0004】

センサ部200は、超音波の送受信を行なう振動子203と、この振動子203と電氣的に接続されたセンサ信号基板204およびセンサグランド基板205と、振動子203の超音波送受面に配置された音響整合板220および音響レンズ207と、振動子203の背面（超音波送受信面とは反対の面）に配置されたバッキング層206とを備えている。更に、センサ部200は、センサコネクタ217を備えており、このセンサコネクタ217はセンサ信号基板204およびセンサグランド基板205と接続されている。

【0005】

ケーブル部201は、信号ライン209aおよびグランドライン209bを含む複数の信号線209と、信号線209と接続されたケーブル基板208と、ケーブル基板208に接続されたケーブルコネクタ218とを備えている。また、ケーブル部201においては、信号線209の外周が、ケーブルシールド210により被覆されており、更にシース211により保護されている。シールド板219は、絶縁層219b表面に導電層219aが形成されたフィルムであり、ケ

ケーブル基板 208 やケーブルコネクタ 218 を囲み、センサ部 200 の外周の一部を囲うように配置され、ケーブルシールド 210 と接続されている。

【0006】

コネクタ部 202 は、本体接続コネクタ 215 と、信号ライン 209 a およびグラウンドライン 209 b が個別に接続されたピン 216 とを備え、コネクタ筐体 214 で収容されている。コネクタ筐体 214 は、その内壁面に導電層 213 を備えている。ケーブルシールド 210 は、この導電層 213 と接続され、超音波診断装置本体と接続した時、超音波診断装置本体のフレームグラウンドあるいは信号グラウンドと接続される。

【0007】

【特許文献 1】

特許第 1746663 号公報

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来例において、振動子 203 のグラウンド電極は、センサグラウンド基板 205 と、センサコネクタ 217 およびケーブルコネクタ 218 を介して、ケーブル基板 208 を経て、グラウンドライン 209 b と接続されている。そのため、コネクタ極数の制約などにより、グラウンド用に十分な極数が確保することが困難であるという問題があった。グラウンド用に十分な極数が確保できないと、センサグラウンド基板とケーブル基板間の抵抗が高くなり、電磁波環境に曝されてノイズ電流がグラウンドに流れた場合、グラウンド電位の変動が生じ、画像ノイズが発生する可能性があった。

【0009】

本発明の超音波探触子は、上記従来の問題点を解決するものであり、センサ部とケーブル部との接続部におけるグラウンド抵抗を低減し、ノイズの少ない超音波探触子を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため、本発明の超音波探触子は、超音波信号を送受信する

振動子と、前記振動子へ、または前記振動子から電気信号を伝送する信号ラインと、前記振動子にグランド電位を供給するグランドラインとを備えた超音波探触子であって、

前記振動子には、センサグランド基板およびセンサ信号基板が電氣的に接続されており、前記センサ信号基板および前記センサグランド基板は、ケーブル基板を介して、それぞれ、前記信号ラインおよび前記グランドラインと電氣的に接続されており、

前記センサグランド基板と前記ケーブル基板とが、直接接続されているか、または、中継グランド基板を介して接続されていることを特徴とする。

【0011】

【発明の実施の形態】

上記超音波探触子においては、振動子とグランドラインとを電氣的に接続するために、振動子に接続されたセンサグランド基板と、グランドラインと接続されたケーブル基板とが、直接、または、中継グランド基板を介して接続されている。そのため、この両者をコネクタを介して接続する場合とは異なり、コネクタ極数の制約に伴う抵抗上昇を回避することができ、このセンサグランド基板とケーブル基板との間のグランド抵抗を低減することができる。そして、このグランド抵抗の低減により、外来電磁によるノイズ電流に起因したグランド電位変化を抑制でき、このグランド電位変化による受信信号への悪影響を低減し、画像ノイズの発生を防止することができる。

【0012】

上記超音波探触子においては、前記センサ信号基板の少なくとも一部が、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板によって、覆われていることが好ましい。

【0013】

また、上記超音波探触子においては、前記ケーブル基板の少なくとも一部が、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板によって、覆われていることが好ましい。

【0014】

また、上記超音波探触子においては、前記センサ信号基板と前記ケーブル基板との接続部が、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板によって、覆われていることが好ましい。

【0015】

これらの好ましい例によれば、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板をシールドとして機能させて、前記センサ信号基板、前記ケーブル基板およびその接続部のうちの少なくとも一部分をシールドすることができ、外部からの電磁波に起因したノイズ発生を抑制でき、超音波探触子の電磁波耐久性を高めることができる。

【0016】

また、上記超音波探触子においては、前記振動子が、前記センサグランド基板または前記中継グランド基板によって、覆われていることが好ましい。この好ましい例によれば、超音波探触子の電磁波耐久性を高めることができる。

【0017】

また、上記超音波探触子においては、前記センサグランド基板が、前記振動子の超音波送受信面を被覆しており、音響整合板として機能することが好ましい。この好ましい例によれば、音響整合板を別途設ける必要がないため、作業性が向上する。

【0018】

以下、図面を用いて、本発明の実施形態について説明する。

【0019】

(第1の実施の形態)

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る超音波探触子の一例を示す図である。この超音波探触子は、電気信号を超音波に変換して生体に送信し、生体からの反射波を受信して電気信号に変換するためのセンサ部100と、センサ部100に対して電気信号を送受信するためのケーブル部101と、探触子を超音波診断装置本体に接続するためのコネクタ部102とを備えている。

【0020】

センサ部100は、振動子103と、振動子103と電氣的に接続されたセン

サ信号基板104およびセンサグランド基板105とを備えている。また、振動子103の超音波送受信面には、超音波を効率良く送受信するための音響整合板（図示せず。）と、超音波を収束し、関心生体内領域の分解能を高めるための音響レンズ107とが設けられている。また、振動子103の背面（超音波放射面とは反対の面）には、超音波を吸収するためのバッキング層106が配置されている。

【0021】

振動子103としては、圧電特性を有する材料が用いられ、例えばチタン酸バリウムなどの圧電セラミックが用いられる。この振動子103の表面には、金属などの導電材料からなる信号電極およびグランド電極が形成されており、これらの電極とセンサ信号基板104およびセンサグランド基板105の導電部とが、それぞれ電氣的に接続されている。両基板の配置については、特に限定するものではないが、例えば、図1に示すように、センサ信号基板104を振動子103の背面の全面を被覆するように配置し、センサグランド基板105を振動子103の超音波送受信面の全面を被覆するように配置することができる。

【0022】

センサ信号基板104としては、絶縁基板表面に導電層が形成されたものが用いられる。絶縁基板としては、例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリサルフォン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、ポリフェニレンサルファイトなどの高分子材料が用いられる。また、導電層としては、例えば、Ni、Cr、Au、Ag、Al、Cu、Tiなどの金属が用いられる。導電層の厚さについては、特に限定するものではないが、例えば30 μ m以下である。この導電層は、所定の形状にパターンニングされており、振動子の信号電極と電氣的に接続されている。この接続は、例えば、半田および導電性接着剤などを介して、または、機械的な接触により実現される。

【0023】

センサグランド基板105としては、センサ信号基板と同様に、絶縁基板105a表面に導電層105bが形成されたものを使用することができる。特に、センサグランド基板105を振動子103の超音波送受信面の全面を被覆するよう

に接続する場合、導電層の厚さは、超音波の送受信を阻害しないような値に設定する必要がある。このような導電層の厚さは、例えば $30\ \mu\text{m}$ 以下である。また、センサグランド基板 105 として、金属などの導電性材料からなる基板を使用してもよい。

【0024】

また、図 1 の例のように、センサグランド基板 105 を振動子 103 の超音波送受信面の全面を被覆するように接続する場合、センサグランド基板 105 として、音響整合機能を有する材料を使用すれば、このセンサグランド基板 105 を音響整合板として機能させることができる。この場合、圧電板から音響レンズ（図示せず。）の間に積層する材料を少なくすることができ、あるいは、別途、音響整合板を設ける必要はないため、センサグランド基板と音響整合板の間の接着剤などによる音響的不整合を抑制でき、かつ、超音波探触子の製作が容易になる。このような音響整合機能を有する材料としては、例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリサルフォン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、ポリフェニレンサルファイトなどの高分子材料に、例えば Ni, Cr, Au, Ag, Al, Cu, Ti などの金属材料が圧電板の面に例えば $30\ \mu\text{m}$ 以下で形成されたものや、あるいは、材料自体に導電性能がある、導電性プラスチックやグラファイトからなる材料などが挙げられる。

【0025】

センサグランド基板 105 の導電層 105b（導電性基板を用いる場合は、その基板）は、振動子 103 のグランド電極と電気的に接続されている。この接続は、センサ信号基板 104 の導電層と同様に、例えば、半田および導電性接着剤などを介して、または、機械的な接触により実現される。

【0026】

図 1 に示すように、センサグランド基板 105 は、センサ信号基板 104 の少なくとも一部を覆うように配置されることが好ましい。このような配置とすることにより、センサグランド基板 105 の導電層 105b がシールド板として機能して、センサ信号基板 104 の少なくとも一部をシールドするため、電磁波耐久性が向上する。この配置は、例えば、図 1 に示すように、センサ信号基板 104

およびセンサグランド基板105を、振動子103から同じ取り出し方向（図1の例においては、振動子の左側）に引き出すことにより、実現することができる。

【0027】

なお、図1の例では、振動子103とセンサグランド基板105の導電部105aとが直接接続されているが、この両者の間に、導電性材料、例えばグラファイト板などを設けてもよい。また、振動子103の超音波送受信面の全面にセンサグランド基板105が接続されているが、これに限定されるものではなく、センサグランド基板105は振動子103の端部にのみ接続されていてもよい。振動子103とセンサ信号基板104との接続部についても、同様に、両者が直接接続されていても、導電性材料を介して接続されていてもよい。

【0028】

ケーブル部101は、複数の信号線109と、これを保護するシース111と、信号線109をセンサ信号基板104およびセンサグランド基板105と接続するためのケーブル基板108とを備えている。

【0029】

信号線109は、各種超音波信号処理を行なう超音波診断装置本体（図示せず。）から送信された電気信号をセンサ部へ伝送、または、生体情報を含む超音波を電気信号に変換した電気信号を超音波診断装置本体へ伝送する信号ライン109aと、センサ部の振動子103にグランド電位を供給するためのグランドライン109bとを含む。この信号線109は、中心銅線を金属編組線などの内部シールド部材で包囲した、同軸構造を有する信号線であることが好ましい。この複数の信号線109は束ねられ、シース111で保護されている。シース111としては、例えば、塩化ビニルおよびシリコンなどの絶縁性材料を使用することができる。また、信号線109とシース111との間には、外来電磁波からのシールドおよび電磁波の輻射を目的とした、例えば、金属編組線、金属箔などのケーブルシールド110が配置されていることが好ましい。

【0030】

前記信号線109は、ケーブル基板108に接続されている。ケーブル基板1

08としては、センサ信号基板104と同様に、絶縁基板表面に導電層が形成されたものを使用することができる。また、ケーブル基板108には電子回路が搭載されてもよい。ケーブル基板108の導電層は、所定の形状にパターンニングされており、これにより信号パターンとグランドパターンとが形成されている。このケーブル基板108の信号パターンは前記信号線の信号ラインと、グランドパターンはグランドラインと、それぞれ、電氣的に接続されている。

【0031】

更に、ケーブル基板108の信号パターンは、センサ信号基板104の導電層と電氣的に接続される。このケーブル基板108とセンサ信号基板104との接続は、例えば、ワイヤボンディング、基板同士の熱圧着、または、カードエッジコネクタやその他のコネクタを介在させて実現させることができる。

【0032】

また、ケーブル基板108のグランドパターンは、センサグランド基板105の導電層105bと電氣的に接続される。本実施形態においては、このケーブル基板108のグランドパターンとセンサグランド基板105の導電層105bとの接続は、中継グランド基板112を介して実現されている。中継グランド基板112としては、例えば、銅線、銅箔フィルムなどの、導電性基板を用いることができる。また、中継グランド基板112の寸法については、特に限定するものではないが、グランド抵抗を更に低減するため、ケーブル基板108のグランドパターンとセンサグランド基板105の導電層105bとの間において、断面積が大きく、距離が短いことが好ましい。また、複数のケーブル基板108が存在する場合は、各々のケーブル基板108と接続された中継グランド基板112を、センサグランド基板105に接続すればよい。

【0033】

中継グランド基板112は、前記センサグランド基板105の導電層105bと接続される。このとき、センサグランド基板105の引出し端部（中継グランド基板112との接続部となる部分である。）を折り曲げることが好ましく、特にこの端部を90°以上、更には約180°折り曲げることが好ましい。センサグランド基板105の導電層105bを外側に露出させることができ、この導電

層 105b と中継グランド基板 112 との接続が容易となるからである。また、中継グランド基板 112 とセンサグランド基板 105 の導電層 105b との接続面積は、できるだけ大きいことが、グランド抵抗が低減されるため好ましい。

【0034】

また、中継グランド基板 112 は、ケーブル基板 108 のグランドパターンと接続される。このとき、図 1 に示すように、中継グランド基板 112 が、センサ信号基板 104 とケーブル基板 108 との接続部を覆う状態となるよう接続することが好ましい。このような配置とすることにより、中継グランド基板 112 がシールド板として機能して、センサ信号基板 104 とケーブル基板 108 との接続部をシールドするため、電磁波耐久性が向上する。その結果、シールド板が不要となり、超音波探触子の製作が容易になり、且つ、筐体の小型化も実現できる。また、中継グランド基板 112 とケーブル基板 108 のグランドパターンとの接続面積は、できるだけ大きいことが、グランド抵抗が低減されるため好ましい。

【0035】

コネクタ部 102 は、本体接続コネクタ 115 と、信号ライン 109a およびグランドライン 109b が個別に接続されたピン 116 とを備え、これらがコネクタ筐体 113 に収容されている。コネクタ筐体 113 は、例えば、金属、樹脂などで構成することができ、その内壁面には金属などの導電層 114 を備えている。ケーブルシールド 110 は、前記ピンと絶縁された本体接続用コネクタの外周部の金属部分、または、コネクタ筐体 113 内面の導電層 114 と接続され、超音波診断装置本体と接続した時、超音波診断装置本体のフレームグランドあるいは信号グランドと接続される。

【0036】

次に、上記超音波探触子により達成される効果について説明する。

【0037】

上記超音波探触子においては、前述したように、センサグランド基板 105 の導電層 105b とケーブル基板 108 のグランドパターンとが、中継グランド基板 112 を介して接続されている。そのため、この両者をコネクタを介して接続

する場合とは異なり、コネクタ極数の制約に伴う抵抗上昇を回避することができるため、センサグランド基板105とケーブル基板108との間のグランド抵抗を低減することが可能となる。更に、このグランド抵抗の低減により、外来電磁によるノイズ電流に起因したグランド電位変化を抑制できるため、このグランド電位変化に伴う受信信号への悪影響を低減することができ、画像ノイズの発生を防止し、良質な超音波画像を提供することができる。

【0038】

また、ケーブル部101とセンサ部100との接続が、ケーブル基板108とセンサ信号基板104との接続部と、ケーブル基板108とセンサグランド基板105との接続部の、少なくともこの2箇所を実現されている。よって、ケーブル部101とセンサ部100との接続強度が向上するという効果も得られる。特に中継グランド基板112を用いているため、ケーブル基板108とセンサ信号基板104との間に引張り応力が加わっても、中継グランド基板112の張力により、センサ信号基板104とケーブル基板108の接続部の剥れなどによる断線を防止することができる。

【0039】

(第2の実施の形態)

第1の実施の形態においては、センサグランド基板の導電層とケーブル基板のグランドパターンとが、中継ブランド基板を介して接続された例を挙げた。しかしながら、本発明においては、この両者を、中継グランド基板を介することなく、直接接続してもよい。このような実施の形態について、以下に説明する。

【0040】

図2は、本発明の第2の実施の形態にかかる超音波探触子の一例を示す模式的な断面図である。この超音波探触子は、第1の実施の形態と同様に、センサ部100、ケーブル部101およびコネクタ部102を有している。

【0041】

センサ部100は、第1の実施の形態と同様に、振動子103と、これに接続されたセンサ信号基板104およびセンサグランド基板105とを備えている。図2の例においては、センサ信号基板104は、振動子103の背面の全面を被

覆するように配置され、且つ、振動子103の両側面側から引き出されている。
また、センサグランド基板105は、振動子103の超音波送受信面の全面を被覆するように配置され、且つ、振動子103の両側面側から引き出されている。
これにより、センサグランド基板105を、振動子103の超音波送受信面および両側面を覆うように配置することができる。このような配置により、センサグランド基板105の導電層105bがシールド板として機能して、振動子103をシールドすることができるため、電磁波耐久性が向上する。

【0042】

なお、センサ部100を構成する各部材の材料および構造などについては、第1の実施の形態と実質的に同様である。特に、本実施形態で示した例においては、センサグランド基板105が振動子103の両側面から引き出されることにより、その超音波送受信面全体を確実に被覆することが可能であるため、センサグランド基板105として音響整合機能を有する材料を用いることにより得られる効果大きい。

【0043】

ケーブル部101は、第1の実施形態と同様に、信号ライン109aおよびグラウンドライン109bを含む複数の信号線109と、シース111と、信号パターンおよびグラウンドパターンを含むケーブル基板108とを備えている。図2の例においては、2枚のケーブル基板108が用いられており、その各々が、振動子103の両側面側から引き出されたセンサ信号基板104およびセンサグランド基板105の両引出部に接続されている。

【0044】

ケーブル基板108の信号パターンは、信号線の信号ライン109aおよび前記センサ部のセンサ信号基板104と電氣的に接続されている。これらの接続については、第1の実施の形態と同様である。

【0045】

また、ケーブル基板108のグラウンドパターンは、信号線のグラウンドライン109bおよび前記センサグランド基板105と電氣的に接続されている。本実施形態において、ケーブル基板108のグラウンドパターンとセンサグランド基板1

05の導電層105bとは、例えば半田などにより、直接接続されている。このとき、図2に示すように、センサグランド基板105が、センサ信号基板104とケーブル基板108との接続部の少なくとも一部を覆う状態となるように、ケーブル基板108とセンサグランド基板105とを接続することが好ましい。このような配置とすることにより、センサグランド基板105がシールド板として機能して、センサ信号基板104とケーブル基板108との接続部をシールドするため、電磁波耐久性が向上する。また、センサグランド基板105とケーブル基板108のグランドパターンとの接続面積は、グランド抵抗を更に低減できることから、できるだけ大きいことが好ましい。

【0046】

なお、ケーブル部101を構成する各部材の材料および構造などについては、第1の実施の形態と実質的に同様である。

【0047】

また、コネクタ部102の構造については、第1の実施の形態と実質的に同様であるため、その説明を省略する。

【0048】

なお、上記説明においては、センサ信号基板およびセンサグランド基板を、振動子の両側面側から引き出した場合を例に挙げたが、第1の実施の形態と同様に、この両基板を振動子の一方の側面側からのみ引き出した構造としてもよい。

【0049】

しかしながら、これらの基板を振動子の両側面側から引き出す構造とすることにより、前述したように、センサグランド基板によって振動子の両側面を覆うことができ、電磁波耐久性が向上するため、好ましい。また、両側面側から引き出した構造とすれば、図2に示すように、ケーブル基板108とセンサ信号基板104との接続部全体を、センサグランド基板105で覆うことができるため、センサグランド基板105でこの接続部をシールドすることができ、電磁波耐久性が向上する。その結果、シールド板が不要となり、超音波探触子の製作が容易になり、かつ、筐体の小型化も実現できるため、好ましい。

【0050】

上記超音波探触子によれば、センサグランド基板105とケーブル基板108とを直接接続する。よって、第1の実施の形態と同様に、両者をコネクタを介して接続する場合とは異なり、コネクタ極数の制約に伴う抵抗上昇を回避することができるため、センサグランド基板とケーブル基板との間のグランド抵抗を低減し、外来電磁によるノイズ電流に起因したグランド電位変化を抑制して、良質な超音波画像を提供することができる。

【0051】

特に、本実施の形態では、センサグランド基板105とケーブル基板108とを直接接続するため、中継グランド基板を用いる第1の実施の形態に比べて、半田などによる接続個所が少なくできるので、作製の作業性がよく、ケーブル部やセンサ部への半田などによる熱ダメージを抑制できる。

【0052】

また、ケーブル部とセンサ部との接続が、ケーブル基板とセンサ信号基板との接続部と、ケーブル基板とセンサグランド基板との接続部の、少なくともこの2箇所で実現されている。よって、ケーブル部とセンサ部との接続強度が向上するという効果も得られる。

【0053】

(第3の実施の形態)

第1および第2の実施の形態においても説明したように、センサグランド基板はシールドとして機能させることが可能である。

【0054】

超音波探触子の小型化、軽量化による操作性の向上のためは、センサ部を収容する筐体を小さくする必要があるが、シールド板を別途設ける場合、その形状や厚みを考慮した筐体内の空間確保が必要であるため、小型化や軽量化が困難である。また、シールド板で、ケーブルコネクタ部を囲うことで、封止材が十分に充填されず、内部構造体の固定が十分にできないおそれがある。また、シールド板では、振動子の超音波送受信面を覆うことができないため、振動子への電磁波の侵入を十分に防止することが困難である。

【0055】

しかしながら、本発明の一実施形態によれば、前述のように、センサグランド基板はシールドとして機能させることにより、別途シールド板を設ける必要がなくなるため、上記のような問題を解決することも可能となる。

【0056】

本実施の形態においては、このセンサグランド基板によるシールド効果が特に高くなるような形態について説明する。

【0057】

図3は、本発明の第3の実施の形態にかかる超音波探触子の一例を示す模式的な斜視図である。この超音波探触子は、センサグランド基板105の形状が異なること以外は、第2の実施の形態と実質的に同様な構造を有する。よって、ここでは、センサグランド基板105の形状について詳説する。

【0058】

センサ部は、第2の実施の形態と同様に、振動子103と、これに接続されたセンサ信号基板104およびセンサグランド基板105とを備えており、センサ信号基板104は、振動子103の背面の全面を被覆するように配置され、且つ、振動子103の両側面側から引き出されている。

【0059】

センサグランド基板105は、振動子103の超音波送受信面の全面を被覆するように配置されており、センサ信号基板104と同様に、振動子103の両側面側から引き出されている。更に、図3に示すように、センサグランド基板105は、センサ信号基板104が引き出されている側以外の側面、すなわちセンサ信号基板104が引き出されている側の側面に隣接する側面をも覆うような形状を有している。これにより、センサグランド基板105による、振動子103に対するシールド効果を更に増大させることができる。

【0060】

ケーブル部は、第2の実施形態と同様に、信号ラインおよびグランドラインを含む複数の信号線109と、シース111と、信号パターンおよびグランドパターンを含むケーブル基板108とを備えている。図3に示すように、2枚のケーブル基板108が用いられており、その各々が、振動子103の両側面側から引き

出されたセンサ信号基板 104 およびセンサグランド基板 105 の両引出部に接続されている。

【0061】

ケーブル基板 108 のグランドパターンは、信号線 109 のグランドラインおよび前記センサグランド基板 105 と電氣的に接続されている。このとき、図 3 に示すように、センサグランド基板 105 がセンサ信号基板 104 とケーブル基板 108 との接続部の全体を覆う状態となるように、ケーブル基板 108 とセンサグランド基板 105 とが接続される。更に、図 3 に示すように、センサグランド基板 105 は、ケーブル基板 108 のグランドパターンが形成された面だけでなく、その面に対して垂直な面（すなわち、側面）をも覆っている。これにより、センサグランド基板 105 による、ケーブル基板 108 に対するシールド効果を更に増大させることができる。

【0062】

図 4 は、上記センサグランド基板 105 の展開図である。図 4 に示すように、上記センサグランド基板 105 は、振動子の超音波送受信面を被覆する面を底面部分とし、この底面部分の四辺にそれぞれ側面部分が連なる形状を有している。なお、図 4 における斜線部分は、ケーブル基板との接続部分を示す。

【0063】

また、センサグランド基板の底面部分には、複数の溝 105c が形成されることが好ましい。この溝は、振動子を電氣的、機械的に多数に分割するために形成されるものであり、この溝により隣接する振動子との機械的結合を弱め、あるいは振動子の機会振動の独立性を高めることで、クロストークの向上や、指向角を広げることができる。溝内には、通常、エポキシやシリコンなどの絶縁性材料が充填されており、柔らかいほうが振動子の機会独立性を高める効果が高い。

【0064】

センサグランド基板 105 の上記側面部分が、振動子 103、センサ信号基板 104 およびケーブル基板 108 の周囲（四方）を囲むように配置される。このとき、センサグランド基板 105 の側面部分のうち、振動子 103 のセンサ信号

基板 104 が引き出されている側以外の側面（ケーブル基板 108 の側面）に引き出された部分は、ケーブル基板 108、または、センサグランド基板 105 の別の側面部分と半田などにより接続されることが好ましい。センサグランド基板 105 の形状を保持することができるからである。

【0065】

このように、本実施の形態においては、センサグランド基板 105 が、振動子 103、センサ信号基板 104 およびケーブル基板 108 の周囲を取り囲むように配置されるため、センサグランド基板 105 による、振動子 103、センサ信号基板 104 およびケーブル基板 108 と、それらの接続部とに対するシールド効果が高くなるため、電磁波耐久性を向上させ、電磁波の侵入などによるノイズ電流を低減することができる。その結果、シールド板を別途設ける必要がなくなるため、超音波探触子の製作が容易になり、かつ、筐体の小型化も実現できる。

【0066】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の超音波探触子によれば、センサグランド基板とケーブル基板とが、中継グランド基板を介して、または直接接続されているため、この両者をコネクタを介して接続する場合とは異なり、コネクタ極数の制約に伴う抵抗上昇を回避することができるため、センサグランド基板とケーブル基板との間のグランド抵抗を低減することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 第 1 の実施の形態にかかる超音波探触子の一例を示す断面図である。

【図 2】 第 2 の実施の形態にかかる超音波探触子の一例を示す断面図である。

【図 3】 第 3 の実施の形態にかかる超音波探触子の一例を示す断面図である。

【図 4】 第 3 の実施の形態にかかる超音波探触子におけるセンサグランド基板の展開図である。

【図 5】 従来の超音波探触子を示す断面図である。

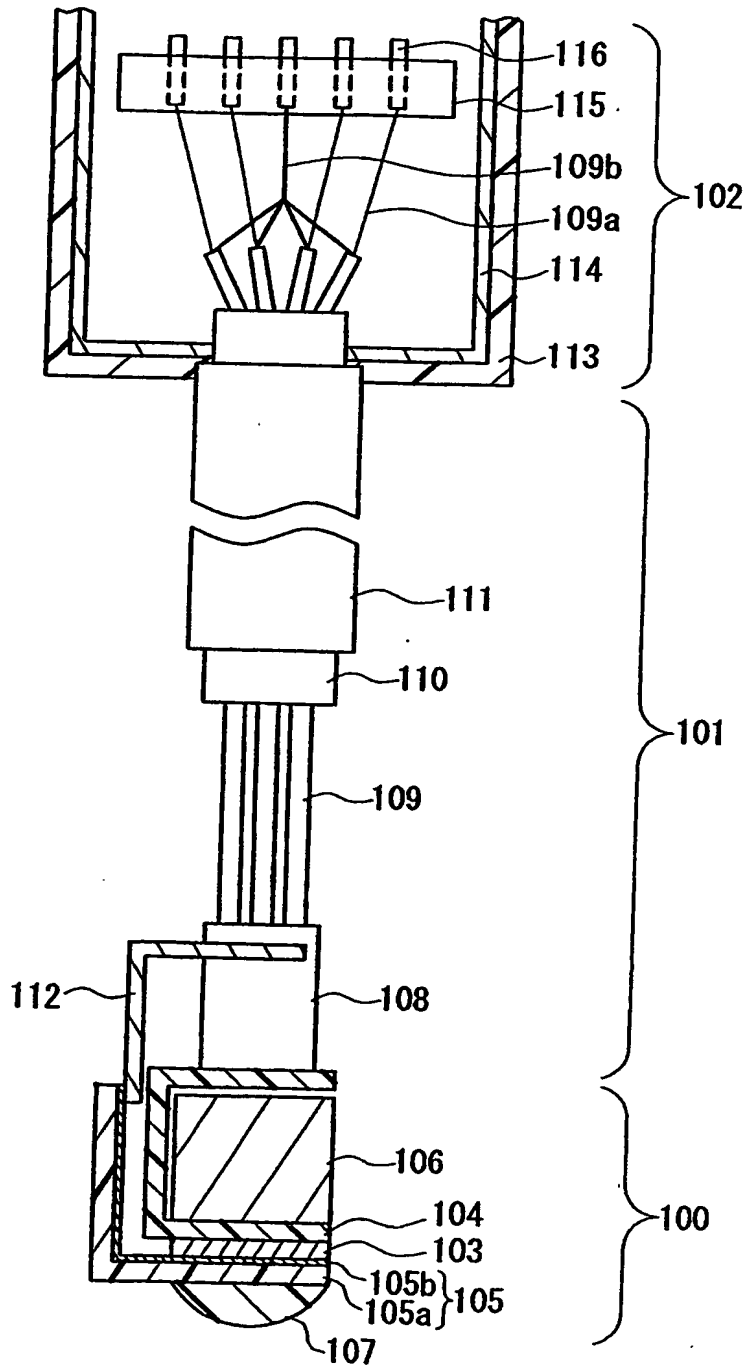
【符号の説明】

- 100、200 センサ部
- 101、201 ケーブル部
- 102、202 コネクタ部
- 103、203 振動子
- 104、204 センサ信号基板
- 105、205 センサグランド基板
- 106、206 バックینگ層
- 107、207 音響レンズ
- 108、208 ケーブル基板
- 109、209 信号線
- 110、210 ケーブルシールド
- 111、211 シース
- 112 中継グランド基板
- 113、213 導電層
- 114、214 コネクタ筐体
- 115、215 本体接続用コネクタ
- 116、216 ピン
- 217 センサコネクタ
- 218 ケーブルコネクタ
- 219 シールド板
- 220 音響整合板

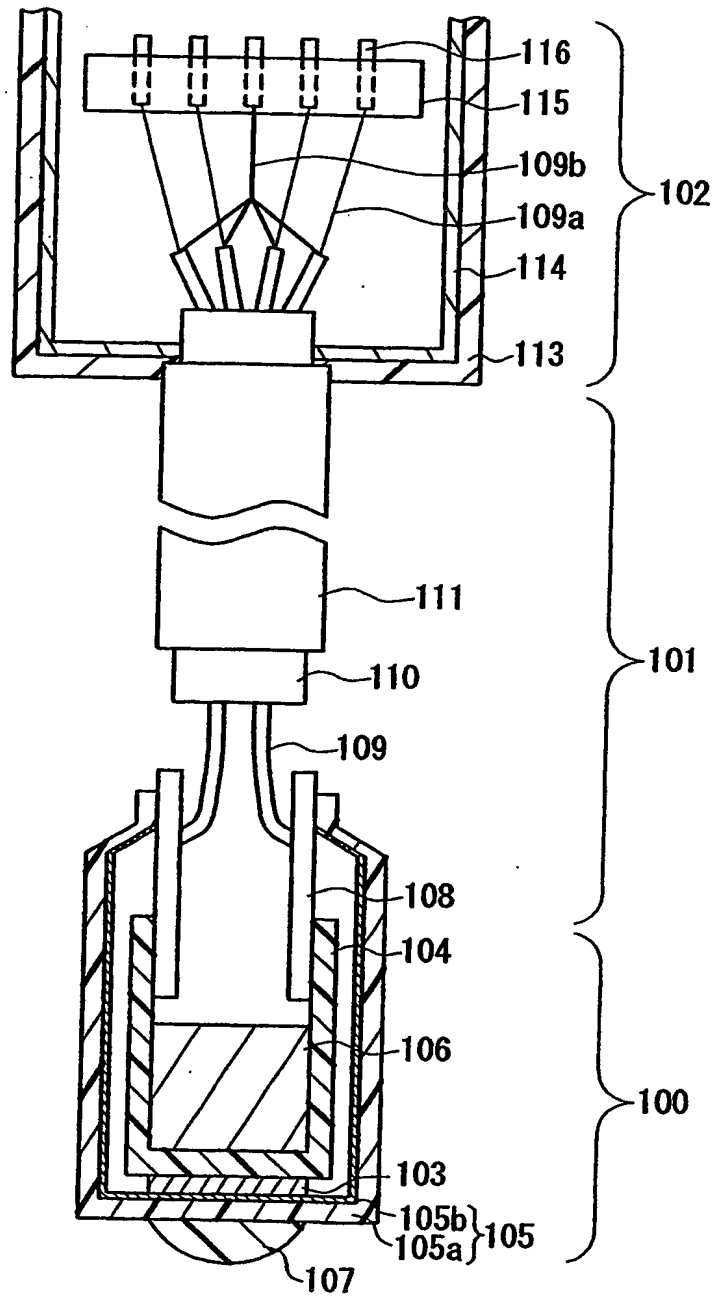
【書類名】

図面

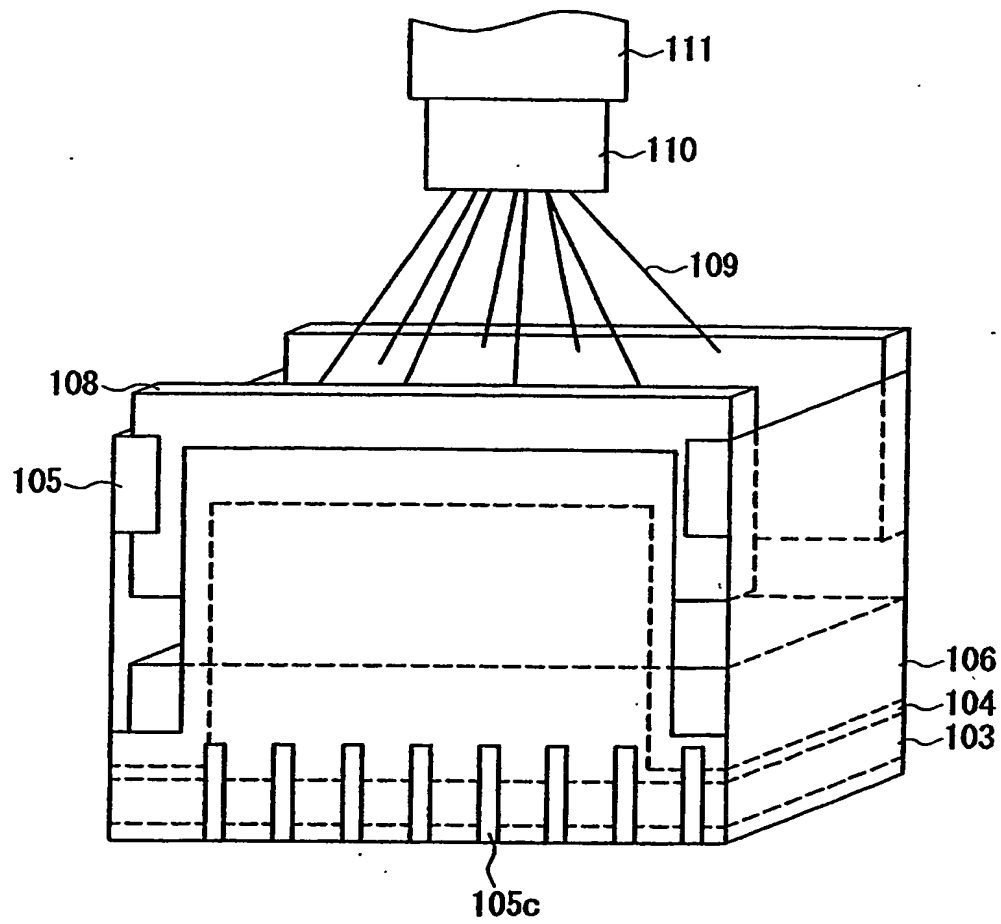
【図 1】



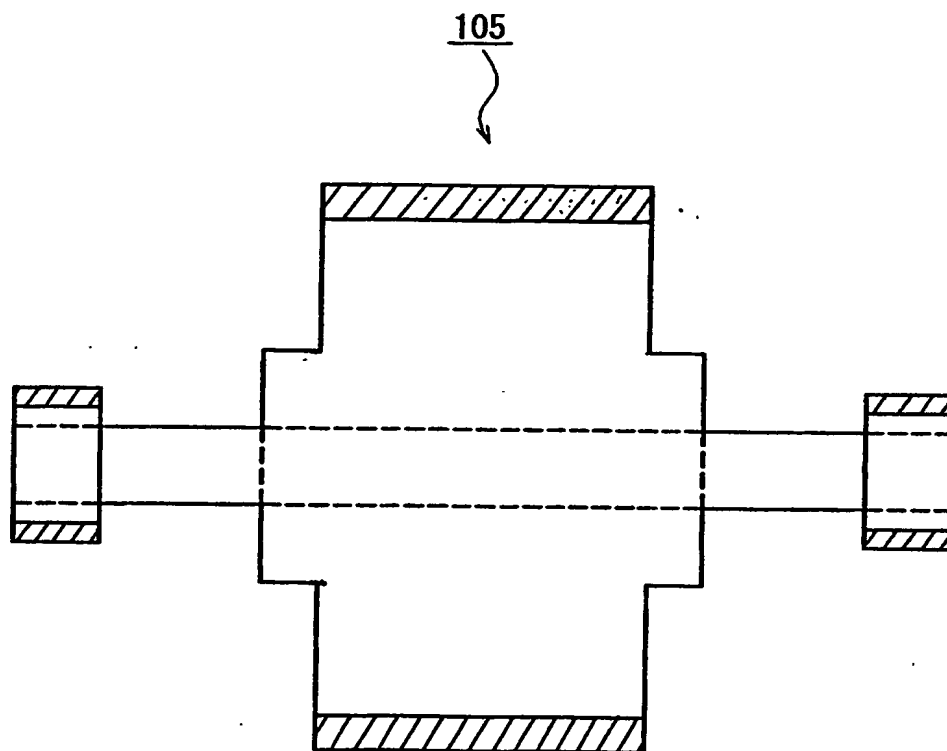
【図 2】



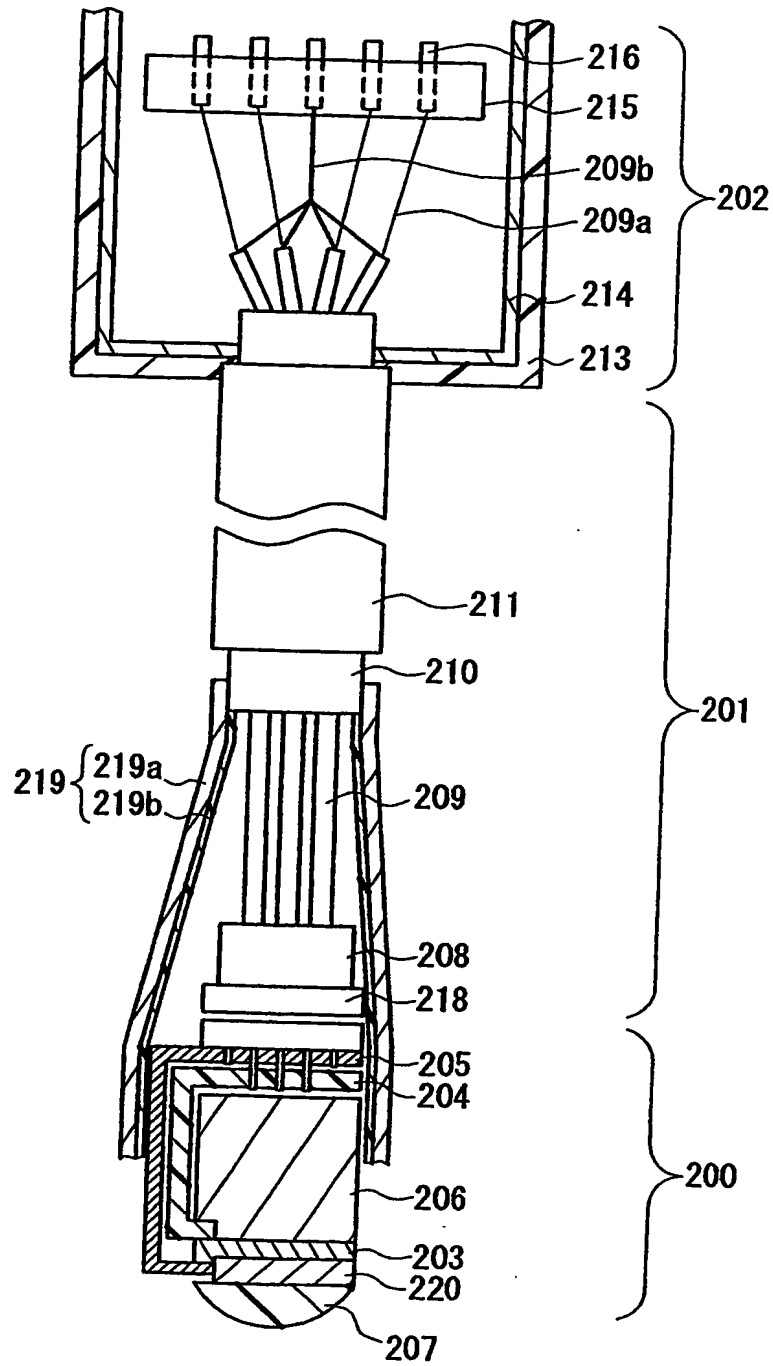
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 振動子と、これにグランド電位を供給するグランドラインとの電気的接続部における抵抗が低減された超音波探触子を提供する。

【解決手段】 超音波信号を送受信する振動子103と、前記振動子103へ、または前記振動子103から電気信号を伝送する信号ライン109aと、前記振動子103にグランド電位を供給するグランドライン109bとを備え、前記振動子103には、センサ信号基板104およびセンサグランド基板105が電気的に接続されており、前記両基板104および105は、ケーブル基板108を介して、それぞれ、前記信号ライン109aおよび前記グランドライン109bと電気的に接続されており、前記センサグランド基板105と前記ケーブル基板108とが、直接接続されるか、または、中継グランド基板112を介して接続されている。

【選択図】 図1

特願 2003-083489

ページ: 1/E

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府門真市大字門真1006番地

氏名

松下電器産業株式会社